



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080804000
2009年1月30日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎

C6727X/SP6727X/D710X/D790X製品 サブストレート基板部材変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design <input type="checkbox"/> Electrical <input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> -
変更内容	C6727X/SP6727X/D710X/D790X 製品 サブストレート基板部材変更 現行：PIN1 インジケータ上部のソルダーマスク穴 無し 変更後：PIN1 インジケータ上部のソルダーマスク穴 有り	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	5月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルにつきましては、3月上旬を予定しています。)	
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) C6727X/SP6727X/D710X/D790X製品について、半田ボール装着のセットアップ時間改善及びサブストレート基板デザイン標準化の為に、フラックス印刷及び半田ボール装着時参照用を使用されるPIN1インジケータランド (NiAu表面処理されたCu) 上部のソルダーマスクに、現行穴の無いサブストレート基板部材を使用して製造していますが、それに替わり穴が有るサブストレート基板部材に変更し認定しました。尚、今回の変更で、ソルダーマスク穴を除き、製品についての互換性 (寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
PIN1インジケータ上部のソルダーマスク穴	無し	有り

理由：半田ボール装着のセットアップ時間改善及びサブストレート基板デザイン標準化の為

詳細：今回の変更に伴い、下図のように BGA パッケージ下面 PIN1 インジケータ上部のソルダーマスクに穴が空いたサブストレート基板部材に変更しました。

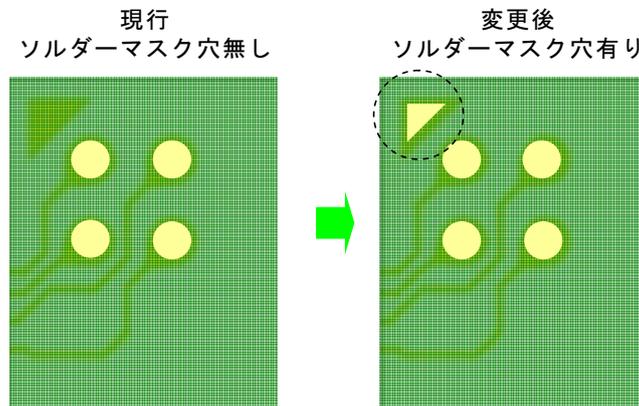


図1 ソルダーマスク穴

対象製品リスト

対象製品名				
320SP6727ZDH3DABT	D790E001BZDH275	SP6727BZDH3DABTE	TMS320C6727BZDH350	TMS320SP6727ZDH3A
D710E001BZDH275	D790E001BZDH300	SP6727BZDH3DBT	TMS320C6727ZDH250	TMS320SP6727ZDH3DA
D710E001BZDH300	SP6727BZDH3D	SP6727BZDH3DBTE	TMS320C6727ZDHA250	TMS320SP6727ZDH3M
D710E001BZDHA275	SP6727BZDH3DA	SP6727BZDH3M	TMS320SP6727BZDH	TMSDC6727BZDHA250
D710E002BZDHA275	SP6727BZDH3DABT	TMS320C6727BZDH300	TMS320SP6727ZDH300	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Device: C6727X/SP6727X/D710X/D790X				
Wafer Fab:	DMOS5	Wafer Technology:	1233C035.A6	
Assembly Site:	TI PHILIPPINES	Package Code/Pins:	ZDH/256	
Mold Compound:	SUMITOMO G770	Moisture Level:	JEDEC LEVEL3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
Assembly Manufacturability	Per mfg. site spec	Approved		